

TIC® 800R-SP 为膏状导热相变材料，能够在工作温度下发生相变，充分填充接触界面的微观空隙，从而显著提升导热效率。材料采用坚固的聚合物相变结构，在典型工作温度范围内展现出卓越的润湿特性，能够与多种基材表面形成紧密接触，实现极低的表面接触电阻。产品经过严苛的长寿命可靠性测试，在高温高湿、温度循环等工况下仍能保持稳定的导热性能与物理特性，充分满足高性能电子设备对长期稳定性的严格要求。



特性

- 》优异的导热率
- 》卓越的表面润湿性
- 》出色的可操作性和可返修性
- 》低热阻
- 》无需加热固化，适用于自动化点胶工艺

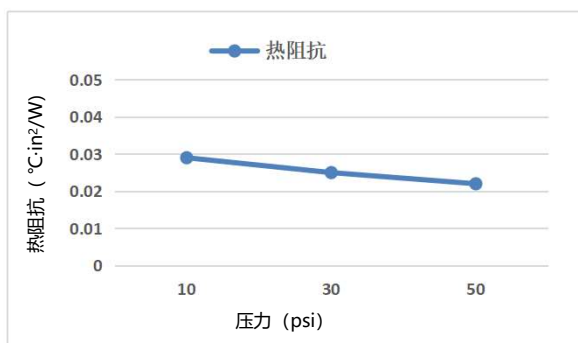
应用

- 》汽车电子与新能源电控系统
- 》信息技术/企业领域
- 》功率半导体器件与模块
- 》消费类电子产品
- 》服务器、数据中心设备

TIC® 800R-SP 特性表

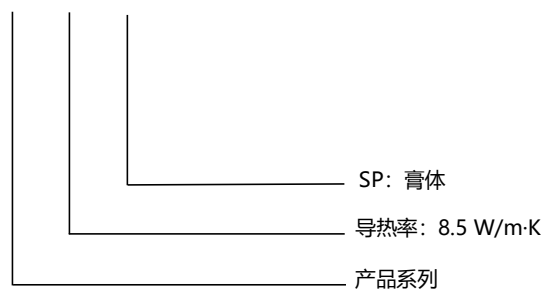
产品特性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
粘度 (mPa·s) @25°C	38000	GB/T 10247
密度 (g/cm³)	2.6	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 125	-
相变温度 (°C)	50~60	-
导热系数 (W/m·K) (去溶剂)	8.5	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in²/W) @10psi	0.03	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in²/W) @50psi	0.02	ASTM D5470
保存期限 (月) @25°C	12 (未开封)	-

热阻抗



产品型号说明

TIC800 R - SP



产品规格

30ml/支, 50ml/支

如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIC800R-SP-0726